



聯絡人

投資人關係

+886 3397 5999 ext. 1204

ir@winfoundry.com

穩懋半導體公告 2019 年第四季自結財務報告

2020 年 02 月 12 日

穩懋半導體，全球最大砷化鎵晶圓代工服務公司，已於今(12)日公告 2019 年第四季自結財務報告。

2019 年第四季財務概況

- ◆ 本季合併營收新台幣 69.04 億元，為歷史新高，較前季增加 8%，較去年同期增加 64%
- ◆ 本季合併毛利率為 44.2%，較前季增加 2.1 個百分點；本季營業淨利率 33.7%，較前季增加 2.3 個百分點；均為歷史新高
- ◆ 本季營業淨利為新台幣 23.29 億元，為歷史新高，較前季增加 16%，較去年同期增加 195%
- ◆ 本季稅後淨利為新台幣 18.40 億元，為歷史新高，較前季增加 12%，較去年同期增加 151%；每股盈餘為新台幣 4.40 元，為歷史新高，前季為新台幣 3.90 元

2020 年第一季展望

下列對於未來展望的表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。請參閱後附之「免責聲明」。

- ◆ 第一季營收預計較前一季下滑 low-teens 百分比。
- ◆ 預計第一季毛利率約為 low-forties 的水準。

免責聲明

本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現況的預期，但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。除法令要求外，公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發生主動更新對未來展望的表述。

管理者評論

“2019年對於穩懋可以說是豐收的一年，儘管年初時產業仍處於低迷的狀態，但隨著智慧型手機市場狀況的改變及客戶的強勁需求，全年營收呈現逐季成長的趨勢。第四季營收達新台幣69.04億元，再次達到單季歷史高點，在產能滿載的狀況之下，毛利率超越上一季達到44.2%的新高峰，在營業利潤率及淨利率也都同創近三年單季新高之下，造就了EPS新台幣4.4元的單季紀錄。2019年全年營收較前一年成長23%，達新台幣213.78億元，全年EPS為新台幣10.59元，亦雙雙改寫歷史新高。

時序邁入2020年，各國政府或電信商無不緊鑼密鼓的加速釋出5G頻譜及從事5G基礎建設，預期手機製造商也將推出多款5G機種以因應需求。根據多家研究機構的估計，預測全球5G智慧型手機的滲透率將從2019年的1%上升到2020年的15~20%及2021年的超過30%的水準，因此可以推測今年5G將開始正式邁入成長期。穩懋做為全球無線通訊功率放大器領導廠商，不僅早在幾年前就已提供客戶相關5G Cellular PA解決方案，並業已於2019年下半年大量出貨，2019全年5G Cellular PA 營收已佔全體Cellular PA 超過一成的里程碑，基地台相關的基礎建設全年營收也較前一年成長超過五成，讓公司對2020年5G的需求成長更具信心。此外，在光電元件方面，2019年3D感測仍延續既有的市場領先地位，展望今年將新增更多的應用及客戶，為公司創造更大的貢獻。為了滿足客戶的需求，穩懋最新的5,000片月產能擴充計畫正如火如荼的進行中，期望為今年旺季貢獻產能。

展望2020年第一季，因工作天數較少及受到傳統淡季效應影響之下，預計季營收將較上一季下滑low-teens 百分比，預計毛利率約為low-forties 的水準。”

關於穩懋半導體

穩懋半導體成立於1999年，位於林口華亞科技園區，是全球首座以六英吋晶圓生產砷化鎵微波積體電路(GaAs MMIC)的專業晶圓代工服務公司。穩懋擁有完整的技術團隊及最先進的砷化鎵微波電晶體及積體電路製造技術及生產設備，客戶群除了全球射頻積體電路設計公司(RFIC Design Houses)外，並致力吸引與全球整合元件製造(IDM)大廠合作。在製程技術發展方面，穩懋以多元化及領先為原則，期能提供客戶最完整的服務。在無線寬頻通訊的微波高科技領域中，穩懋目前提供兩大類砷化鎵電晶體製程技術：異質接面雙極性電晶體(HBT)和應變式異質接面高遷移率電晶體(pHEMT)，二者均為最尖端的製程技術。在光通訊及3D感測領域中，穩懋更以MMIC生產技術為基礎，提供光電產品的開發與生產製造。